倒装 GaN 基发光二极管阵列微透镜的 粗化技术*

刘志强* 王良臣 伊晓燕 王立彬 陈 宇 郭德博 马 龙

(中国科学院半导体研究所 集成技术中心,北京 100083)

摘要:通过模拟计算,分析了阵列微透镜粗化对倒装结构 GaN 基 LED 提取效率的影响.并采用感应耦合等离子 (ICP)干法刻蚀技术在蓝宝石表面制备阵列微透镜,实现倒装结构 GaN 基 LED 出光面粗化.测试结果表明,相对 于普通倒装结构,阵列微透镜表面粗化可以使 LED 提取效率提高约 50%,测试结果与模拟计算值相符合.

关键词: GaN 基 LED; ICP; 阵列微透镜; 粗化
PACC: 4280L; 4225B; 7280E
中图分类号: TN312^{*}.8
文献标识码: A

文章编号: 0253-4177(2007)S0-0496-04

1 引言

作为新一代环保型固态光源,GaN基 LED 已 成为人们关注的焦点.与传统光源相比,LED 具有 寿命长、可靠性高、体积小、功耗低、响应速度快、易 于调制和集成等优点.在信息显示、图像处理等领域 得到广泛应用,并有望替代白炽灯、荧光灯,进入普 通照明领域.对于高效照明用 LED,发光效率是其 最重要的参数.目前,GaN 蓝光 LED 发光效率为几 lm/W,GaN 白光 LED(蓝光+荧光粉)的发光效率 通常为几十 lm/W,因此,如何提高 LED 发光效率 成为 LED 面临的一个主要技术瓶颈^[1~6].

GaN 基 LED 发光效率由发光二极管的内量子 效率和光提取效率决定.随着材料生长技术以及器 件结构设计的进步,内量子效率已经可以达到 80% 左右.但受 GaN 材料吸收、电极吸收,以及 GaN/空 气界面全反射临界角等因素影响,GaN 基 LED 光 提取效率只有百分之几,仍然有很大的提升空间.

表面粗化是一种有效提高 LED 提取效率的方法.其机理是通过对出光面粗化,增加出光面积,减少光线在器件内的全反射,使更多的光线以散射光的形式出射.目前应用于 GaN 基 LED 中的粗化技术主要局限于 GaN 面湿法腐蚀粗化.该工艺通常要在高温或光辅助条件下实现,因此工艺操作复杂,重复性、可控性差,并且不适用于以蓝宝石为出光面的倒装结构 GaN 基 LED^[7,8].

本文通过模拟计算,分析了宝石面阵列微透镜

†通信作者.Email:lzg@mail.semi.ac.cn

2006-11-21 收到

粗化对倒装结构 GaN 基 LED 提取效率的影响;并 采用 ICP 刻蚀技术,于倒装 LED 蓝宝石表面制作 阵列微透镜,实现倒装结构 LED 出光面粗化.实验 结果表明,相对于普通倒装结构,蓝宝石面阵列微透 镜粗化技术可使器件提取效率提高约 50%,实验结 果与理论计算值相一致.

2 实验

实验中选用 GaN 外延片结构如下:蓝宝石衬底,1.5µm Si 掺杂 n-GaN,0.05µm InGaN/GaN 多量子阱,0.25µm p-GaN.器件制作工艺主要包括: ICP 技术刻蚀台面至 n-GaN 层,电子束蒸发制作 n 电极,电极体系选用 Ti/Al/Ti/Au,退火温度 600~ 700℃,蒸发过程中应注意控制蒸发速率和温度,保 证良好的电极表面及可剥离性;p 电极采用 Ni/Au 透明电极加 Ag 高反射电极,空气氛围 500℃下合 金.蓝宝石面微透镜制备工艺主要包括:通过光刻在 蓝宝石表面制备均匀分布的半径为 6µm 的光刻胶 圆盘;115℃条件下加热 15min,通过光刻胶热阻回 流形成半球;以半球形光刻胶为掩膜,通过 ICP 干 法刻蚀将图形复制到蓝宝石表面.最后将 GaN 芯片 通过植球与 Si sub-mount 键合,实现芯片倒装,芯 片结构如图 1 所示.

3 Monte-Carlo 光线追踪模拟

采用 Monte-Carlo 光线追踪的方法,分析蓝宝

^{*&}quot;十五"国家重大攻关计划资助项目





石面阵列微透镜粗化对倒装结构 GaN 基 LED 提 取效率的影响.该模拟的主要机理如下:首先根据器 件的结构建立图2所示模拟模型,然后对各层材料 的折射率、吸收系数等主要物理光学参数进行设定, 使模型可以准确地反映器件实际情况.模拟过程中, 有源区随机出射的光线,经过各层介质层吸收及各 光学界面的反射、折射,最终逸出 LED.通过统计逸 出光线的功率总和,与有源区输出的光功率相比,得 到 LED 的提取效率.



图 2 模型结构示意图 Fig.2 Structure of model

模拟过程中,结合图 1 所示 GaN 基 LED 的结 构特点,做如下假设:有源区辐射机制为自发辐射, 自发辐射偏振方向和传播方向各向同性,并且是随 机分布的;有源区输出光功率为 1W; LED 工作在 稳态情况下;光子产生率与损耗率符合稳态速率方 程;模型中 GaN 材料吸收系数取 100cm^{-1[8]},GaN 材料和蓝宝石的折射率分别取 2.4 和 1.76,每个微 透镜单元为半径 6mm 的半球形.

图 3 为输出光线的模拟结果直观示意图,从图 中可以看出,有源区发出的光线一部分因为界面折 射率差被限制在器件内部,另外一部分从蓝宝石出 光面逸出.通过统计粗化前后 LED 逸出光线的光



图 3 模拟结果直观示意图 Fig. 3 Schematic result of the model

功率,与有源区输出的光功率相比,可以最终得到器件的光提取效率.模拟结果表明,阵列微透镜粗化可以使 GaN 基倒装 LED 提取效率提高约 70%.

4 实验结果与讨论

微透镜阵列粗化后蓝宝石表面及断面形貌如图 4 所示.从图中可以看出,通过光刻胶热回流掩膜及 ICP 刻蚀技术,半球形微透镜阵列被成功地制备于 蓝宝石表面,图形一致性较好.为考察阵列微透镜粗 化对器件提取效率的影响,我们测量了未经封装的、



图 4 蓝宝石粗化后表面及断面形貌 Fig. 4 Surface and cross section optical microscopies of the fabricated sapphire microlens arrays

采用阵列微透镜粗化后的 LED,在不同输入电流条 件下的输出光功率,并与相同材料结构、同一工艺条 件下制备的未经粗化的芯片进行比较.结果如图 5 所示.



图 5 输出光功率与输入电流关系曲线 Fig.5 Output power as a function of current

从图中可以看出,阵列微透镜粗化,可以有效提 高倒装结构 GaN 基 LED 的输出光功率.350mA 工 作条件下,采用阵列微透镜粗化的 LED 的蓝光输 出光功率为 81mW,与传统结构芯片比较,提高约 50%.同时从图中还可以看到,经过粗化的器件具有 更高的饱和电流,这是因为,表面粗化减少了光线在 芯片内的全反射,提高了器件光提取效率,从而降低 了因为光线吸收引起的热效应.实验测量的光提取 效率增加幅度略低于理论计算值,其可能的原因是: 理论计算过程中,假定微透镜紧密排布,目形状为规 则的半球形;而实际工艺过程中,由于工艺条件的差 异,一部分微透镜可能呈球冠状,而不是完整的半 球,同时,由于光刻胶的热阻回流,也会使微透镜半 径减小,透镜单元间产生空隙,这些因素在一定程度 上减小了器件的出光面积,最终导致器件实测提取 效率增量与理论计算值比较略有降低.

5 结论

通过模拟计算,分析了阵列微透镜粗化对倒装 结构 GaN 基 LED 提取效率的影响,并采用光刻胶 热回流掩膜及 ICP 刻蚀技术,成功地将半球形微透 镜阵列制备于蓝宝石表面,实现了倒装结构 LED 出光面粗化.测试结果表明,相对于传统倒装结构, 阵列微透镜表面粗化可以使 LED 提取效率提高约 50%,实验值与理论计算结果相一致.同时该技术与 通常采用的 GaN 面湿法腐蚀粗化比较,具有工艺相 对简单、可控性好、重复率高、对有源区无损伤等优 点.

参考文献

- [1] Kao C C, Kuo H C, Huang H W, et al. Light-output enhancement in a nitride-based light-emitting diode with 220 undercut sidewalls. IEEE Photonics Technol Lett, 2005, 17(1);19
- [2] Krames M R, Ochiai-Holcomb M. High-power truncated inverted-pyramid (Al_x Ga_{1-x})_{0.5} In_{0.5} P/GaP light-emitting diodes exhibiting >50 external quantum efficiency. Appl Phys Lett, 1999, 75(16):2365
- [3] Chio H W, Jeon C W, Dawson M D, et al. Mechanism of enhanced light output efficiency in InGaN-based microlight emitting diodes. J Appl Phys, 2003, 93(10):5978
- [4] Kawakami Y, Narukawa Y, Omae K, et al. Dimensionality of excitions in InGaN-based lighting devices. Phys Status Solidi A,2000,178(1):331
- [5] Nishida T, Saito H, Kobayashi N. Efficient and high-power AlGaN-based ultraviolet light-emitting diode grown on bulk GaN. Appl Phys Lett, 2001, 79(6):711
- [6] Schnitzer I, Yablonovitch E, Caneau C, et al. 30% external quantum efficiency from surface textured thin-film light emitting diodes. Appl Phys Lett, 1993,63(16):2174
- [7] Huh C, Lee K S, Kang E J, el al. Improved light-output and electrical performance of InGaN-based light-emitting diode by microroughening of the p-GaN surface. J Appl Phys, 2003,93(11):9383
- [8] Fujii T, Bao Y, Sharma R, et al. Increase in the extraction efficiency of GaN-based light-emitting diodes via surface roughening. Appl Phys Lett, 2004, 84(6):855

増刊

Liu Zhiqiang[†], Wang Liangchen, Yi Xiaoyan, Wang Libin, Chen Yu, Guo Debo, and Ma Long

(Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 10083, China)

Abstract: The effect of surface roughness of microlens arrays on the performance of flip-chip GaN-based LEDs was investigated by simulation, and microlens arrays were fabricated on sapphire to fulfill surface roughening in flip-chip GaN-based LEDs. The results indicate that compared with conventional flip-chip GaN-based LEDs, microlens arrays roughening can improve the extraction efficiency with a factor of 1.5, and the experimental results are in good agreement with the simulation results.

Key words: GaN-based LED; ICP; microlens arrays; roughening PACC: 4280L; 4225B; 7280E Article ID: 0253-4177(2007)S0-0496-04

^{*} Project supported by the National Tackle Key Item in the Tenth Five-Year Plan

[†] Corresponding author. Email: lzq@mail. semi. ac. cn Received 21 November 2006